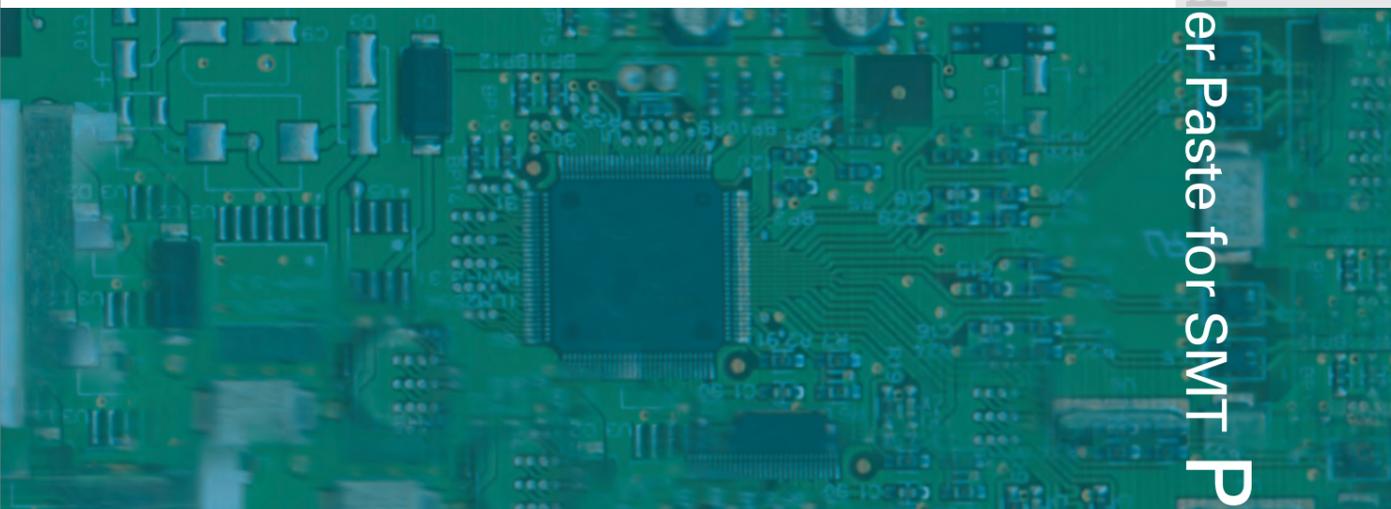


PF305-117TO(TF)

SMT用鉛フリーソルダペースト

低ハロゲンタイプ

- 低ハロゲンでありながら良好なぬれ性。
Good wettability even low halogen.
- 優れた加熱ダレ防止効果を継承。
The excellent avoided heat slumping.



● 一般特性 General characteristics

項目 Items	代表特性 Typical Property	試験方法 Test method
合金組成 Alloy composition	Sn-3.0Ag-0.5Cu	-
粒度 Particles Size	20~38 μm	-
フラックス含有量 Flux content	11.5%	JIS Z 3197
ハロゲン含有量 Halide content (chlorine conversion)	0.03%	配合値 Blend Value
銅板腐食試験 Copper plate corrosion test	Pass	JIS Z 3284
クロム酸銀試験 Silver chromate paper test	Pass	JIS Z 3197
銅鏡試験 Copper mirror test	Pass	JIS Z 3197
絶縁抵抗試験 Electric insulation resistance test, SIR	40°C90%RH: 1.4 × 10 ¹³ Ω 85°C85%RH: 4.3 × 10 ⁹ Ω	JIS Z 3284 JIS Z 3284
100g以上粘着保持時間 Tackiness time of keeping 100g (50kN/m ²) minimum	24 hours	JIS Z 3284
流動特性 Fluidity	粘度 Viscosity: 213 Pa·s Ti値 Thixotropic index: 0.63	JIS Z 3284 JIS Z 3284

上記特性値は代表値で保証値ではありません。The physical property values of above are not the specification of the product.

Low Halogen Type Solder Paste for SMT PF305-117TO(TF)

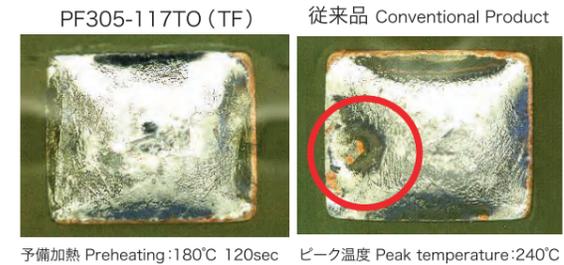
PF305-117TO(TF)

SMT用鉛フリーソルダペースト

低ハロゲンタイプ

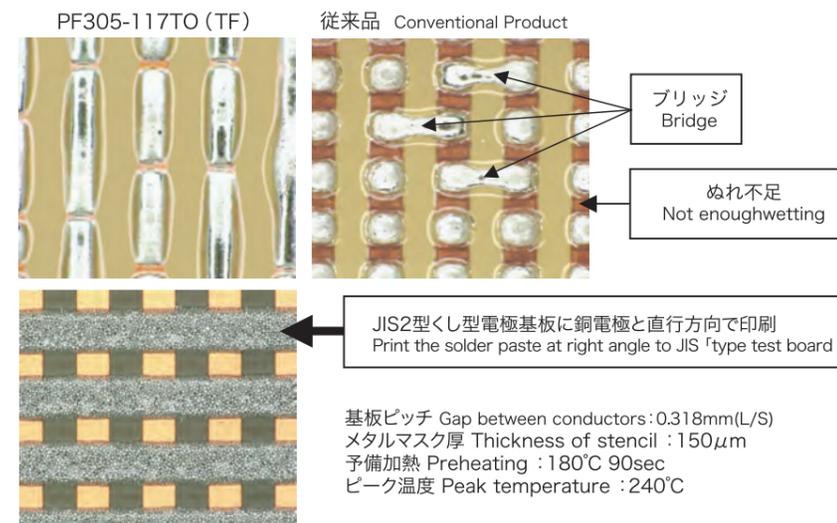
低ハロゲンでありながら良好なぬれ性
Good wettability even low halogen.

電子機器における
ハロゲンフリーの要求
The electronic applications required
for halogen free.
塩素 (Cl) < 900 ppm
臭素 (Br) < 900 ppm
合計 Total < 1500 ppm



予備加熱 Preheating:180°C 120sec ピーク温度 Peak temperature:240°C

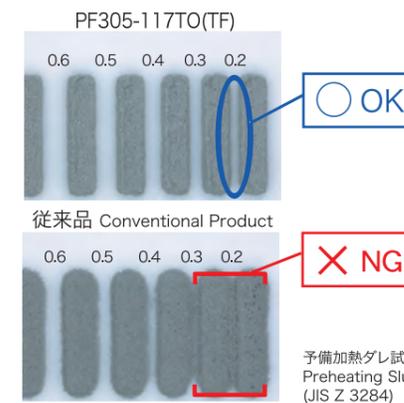
良好なぬれ性によりブリッジを低減
Reduce the bridge by good wettability



JIS2型くし型電極基板上に銅電極と直行方向で印刷
Print the solder paste at right angle to JIS 2 type test board

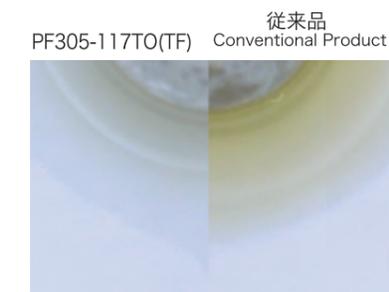
基板ピッチ Gap between conductors:0.318mm(L/S)
メタルマスク厚 Thickness of stencil:150μm
予備加熱 Preheating:180°C 90sec
ピーク温度 Peak temperature:240°C

優れた加熱ダレ防止効果
The excellent avoided heat slumping



予備加熱ダレ試験
Preheating Slumping Test
(JIS Z 3284)

透明なフラックス残渣
The transparent flux residue



試験基板 Test Board:セラミック板Ceramics
予備加熱 Preheating:180°C 120sec
ピーク温度 Peak temperature:240°C

Low Halogen Type Solder Paste for SMT PF305-117TO(TF)